

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需要，并综合考虑资金使用计划，公司及子公司拟向银行增加不超过人民币5亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司本次向银行申请综合授信额度后，公司综合授信总额度将提高至10亿元。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。有效期至下一次年度股东大会。

本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于拓宽公司的融资渠道，为公司日常经营业务的正常开展提供保障，不会对公司的日常经营和业务发展造成不利影响。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公



濮阳惠成电子材料股份有限公司

司及其他股东利益的情形。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2023年10月26日